



半导体行业月度深度跟踪：关注需求和库存边际变化 静待行业景气拐点



近期市场关注半导体周期拐点相关议题，基于我们的研究框架与产业数据跟踪，当前半导体需求仍然呈现结构分化趋势，以手机/PC 为代表的消费类需求仍显疲弱，汽车/光伏等细分需求是相对亮点。半导体行业尤其是消费类仍面临较大去库压力，整体半导体景气度处于边际变弱趋势中，明年中左右有望迎来景气触底回升，建议持续关注需求和库存边际变化，静待行业景气拐点，并把握板块投资的提前布局时机。

行情回顾：11 月半导体板块全球以及国内指数整体下行。11 月，半导体 (SW) 行业指数+1.25%，同期电子 (SW) 行业指数+1.07%，沪深 300 指数+6.08%；2022 年至今，半导体 (SW) 行业指数涨幅-11.68%，同期电子 (SW) 行业指数-22.49%，沪深 300 指数为-25.72%。11 月费半指数/中国台湾半导体指数+17.65%/+23.33%；2022 年年初至今，费半指数/中国台湾半导体指数涨幅分别为-0.87%/-6.32%。

行业景气跟踪：消费类需求整体疲弱，汽车/光伏等保持相对景气。

1、需求端：手机/PC 等消费类需求库存调整压力仍大，汽车/光伏等半导体需求较强。手机：“双十一”销量同比下滑，Q4 需求未见恢复，IDC 预计全年出货量将下降 9.1%。PC：Q3 全球出货量同比跌幅扩大到-15%，苹果逆势同比+40%，IDC 预计全年出货量将下降 12.8%；新能源车：10 月中国乘用车销量同比+11%/环比-4%，新能源车销量同比+86%/环比+1%，同比增幅皆收窄；11 月新能源汽车品牌销量分化明显。服务器：国内外表现分化，国外需求目前优于国内，信骅 M10 营收环比提升。

2、库存端：各板块库存情况呈现显著差异，消费类库存调整持续到23H1。

从终端产品库存来看，此前安卓手机渠道库存压力较大，在历经Q2~Q4的大幅库存去化之后，目前O/V/M的手机库存已逐渐接近安全水位；从终端厂商及渠道端的芯片库存来看，安卓手机类芯片库存已大幅去化，去库压力减弱；安防厂商出于供应链安全考虑，芯片库存将保持高位，汽车、工业类客户的内部芯片库存处于正常水位。IDM/设计类公司分化明显，全球手机链芯片厂商库存和DOI环比上行持续创新高，国内手机链芯片厂商连续多季高增长，部分手机链芯片厂商DOI接近300天，预计未来两三季度仍面临库存调整；PC链芯片厂商库存和DOI 22Q3环比持续提升，英伟达游戏和可视化平台业务持续调整渠道库存；英飞凌FY22Q4表示汽车MCU、新能源IGBT、SiC和模拟混合信号产品供应仍然紧缺，ADI FY22Q4预期23H1库存将继续增加。全球功率厂商库存环比增长，DOI处健康水位；全球MCU厂商表示汽车领域存在补库存需求，积极降低消费电子库存积压影响；国际模拟大厂DOI处于历史较低水位，库存环比上行创近五年季度新高。

3、供给端：全球晶圆产线22Q4产能利用率预期环比持续下滑，产能扩张预期放缓。UMC、SMIC、世界先进等逻辑厂商预期22Q4产能利用率持续环比下滑，存储厂商美光、SK海力士等均主动下调产能利用率以减产，全球晶圆产线扩张进度减缓，2023年整体资本支出尤其是存储端预

期明显下滑；设备与材料方面，2023 年全球存储设备支出明显下滑，日本半导体设备协会表示 2022 年设备高支出或将告一段落，但 8/12 寸硅片依旧供不应求，主要系老产线改造基本被填满，产能扩张有待新产线开出。

4、价格端：11 月存储价格继续环比下滑，MCU 价格持续疲软，模拟渠道价格逐步趋稳。11 月 DXI 指数继续加速下行，11 月底指数较月初下跌 5%，部分型号 DRAM 合约价接近历史低位，NAND 合约价也在加速下行；利基 NOR 和 DRAM、消费类 EEPROM 价格仍维持低位。MCU22Q3 国内消费类、电动工具、家电等 MCU 原厂价格压力依旧较大，表计类原厂价格相对稳定。模拟芯片信号链、传感器、开关稳压器等产品 22Q3 价格逐步趋稳。

5、销售端：国外产业链各环节厂商 Q3 收入表现分化，Q4 指引不甚乐观。

SIA 数据显示 22M10 全球半导体销售 468.6 亿美元，同比-4.6%/环比-0.3%。由于消费电子需求持续疲软，工业内部分细分领域需求疲软扩大，全球处理器厂商 22Q3 营收总体符合预期，ADM 营收低于预期，高通/联发科/AMD 由于下游中消费类占比较大于是均预期 22Q4 营收环比下降。国际功率大厂下游中汽车和光伏等新能源电力占比较高，尽管毛利率预计目前达到相对高位，仍看好后续 SiC 加速成长趋势。模拟大厂 TI22Q3 业绩环比相对持平，后续叠加工业市场疲软开始扩大，预计 22Q4 业绩将环比下滑。国际 MCU 大厂 ST 在汽车市场需求强劲，目前订单能见度为 18

个月，汽车业务预期业绩持续向好。海外设备厂商订单积压，收入环比依旧增长，国内设备及材料厂商 Q3 营收均同比稳健增长。

产业链跟踪：大部分板块季报业绩承压，建议关注细分景气赛道。

1、汽车半导体：国内电动车厂竞争激烈，关注智能化趋势带来的车规半导体机遇。11 月新车极氪 009 采用 Mobileye 和高通 8155 芯片，后驱采用 SiC 技术，建议关注汽车智能化带来传感器和高算力芯片需求提升，以及高压快充和充电桩对功率和模拟芯片等的拉动。

2、设计/IDM 方面，手机和 PC 等消费类继续承压，汽车等领域表现强劲。

1) 处理器：汽车和数据中心业务市场需求相对较好，关注向汽车核心处理器布局的公司。英伟达 22Q3 汽车和数据中心业务季度营收创历史新高，游戏和可视化平台业务需求不振，高通预计 2022 年全年智能手机销量同比下降两位数，下季度 FY23Q1 营收指引同比下降-10.28%；联发科表示 22Q4 是客户库存调整最大的季度；英特尔表示 22Q3PC 需求进一步恶化，企业需求开始放缓，预计 2022 年 PC 销量将下降到 2.95 亿台。国内 SoC 厂商多集中于消费类产品，瑞芯微等部分厂商已推出汽车核心处理器产品，关注未来国内处理器芯片厂商在车规级主芯片放量的潜在机会。

2) MCU：国内外表现有所分化，国内厂商加速布局车规 MCU。海外瑞萨、NXP 的 MCU 汽车/工业占比较高，ST 等大厂逐步将 MCU 产能从

消费向工业/汽车倾斜，海外原厂价格表现健康；由于国内 MCU 厂商产品以消费类、小家电、电动工具为主，当前需求持续疲软且面临价格下滑和晶圆成长上涨等压力，预计 22Q4 业绩同环比表现压力较大；国内厂商兆易、中颖、峰昭等积极布局车规 MCU，看好长期国内 MCU 厂商产品结构升级态势。

3) 存储：标准存储价格持续下跌，利基存储厂商 10 月营收环比下滑明显。

11 月部分 DRAM 合约价跌至历史低位，NAND 价格走势也持续疲软。整体行业仍处于去库存状态，预计需求可能在 23Q2 复苏，DRAM 或将先于 NAND 复苏。利基存储方面，旺宏和华邦电 10 月营收均环比下滑明显，22Q4 产能利用率预计持续下滑。

4) 模拟：ADI 展望汽车领域上行确定性更高，国内模拟芯片厂商均逐步布局车规级产品。ADIFY22Q4 营收符合预期，预计 FY23Q1 通信业务营收下降中等个位数，消费业务下降两位数，工业持平，汽车有望环比小幅上涨。

国内模拟芯片公司均逐步开启车规级道路，纳芯微车规级持续放量，磁传感器等新品逐步从光伏和工业向汽车拓展，思瑞浦车规级放大器和线性电源持续放量，灿瑞科技预期 23 年汽车和光伏营收占比将更为显著，芯朋微定增募投向车规级电源管理新品进军，帝奥微照明产品已顺利上车。库存去化力度较大的晶丰明源逐步推出高性能计算 DCDC 电源新品。

5) 射频: Q3 主要公司存货上涨趋势已止住, Q4 库存减值压力仍大, 23Q3 迎来业绩同比转正。海外龙头 Qorvo 表示由于面临行业需求不振及库存调整, 公司降低了工厂的产能利用率, 预计 Q4 收入中值同比-35%, 毛利率同比-5.7pcts。从国内厂商看, 卓胜微、唯捷创芯 Q3 业绩受下游需求、库存减值的影响很大, 预计 Q4 仍将有较大的库存调整压力。23Q3 有望迎来业绩同比转正, 同时建议关注高端滤波器及发射模组拓展进展。

6) CIS: 中低端 CIS 库存调整压力较大, 汽车为结构性增长点。索尼表示 Q3 中国智能机需求未见改善, 中低端 CIS 需求压力大, 但高端机型产品大尺寸、高分辨率的升级需求仍在持续, 未来重心转向高端机型和汽车市场。

Q3 韦尔/格科微/思特威都受到了手机、安防等下游需求疲软的影响, 预计 Q4 行业仍将面临需求及库存调整压力。

7) 特种 IC: 行业需求持续旺盛, 国内企业在手订单逐步释放。国内军费支出不断扩大, 对特种 IC 采购需求逐步增加, 国内企业此前普遍产能紧张, 同时疫情一定程度影响了发货速率, 但行业高景气度持续, 国内疫

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49972

